

Product Lineup

Thermalnite®



▶ Thermalnite®

特徴：繊維長 D50 : 20 μ m

繊維径 D50 : 5 μ m

用途：放熱シート、ギャップフィラー、
接着剤、封止樹脂、熱可塑性樹脂

▶ Thermalnite® 粉体

特徴：繊維長 D50 : 10 μ m

繊維径 D50 : 5 μ m

用途：グリース、接着剤、
アンダーフィル

※上記製品に表面処理対応可能

放熱シート



▶ 低熱抵抗放熱シート

厚み：0.08, 0.1, 0.15, 0.2mm

熱伝導率：4.6W/m・K

応用製品：コントローラー、電源、
光トランシーバー、SSD、
LED、LDなど

▶ 高熱伝導放熱シート

厚み：0.5, 1.0mm

熱伝導率：12W/m・K

応用製品：パワーモジュール、
モータードライブユニット、
通信モジュールIC、CPU

ハイブリッドフィラー



▶ ハイブリッドフィラー 大粒子

特徴：Thermalnite+ 球状AlN、

D90 : 180 μ m

熱伝導率：15W/m・K

用途：放熱シート、ギャップフィラー、
熱可塑性樹脂など

▶ ハイブリッドフィラー 小粒子

特徴：Thermalnite+ 球状AlN、

D90 : 60 μ m

熱伝導率：4.6W/m・K

用途：放熱シート、接着剤、
アンダーフィル、封止樹脂など

▶ ハイブリッドフィラー 極小粒子

(開発品)

特徴：Thermalnite+ 球状AlN、

D90 : TBD

熱伝導率：3W/m・K

用途：グリース、接着剤、
アンダーフィル、封止樹脂など

※上記製品に表面処理対応可能

セラミックス基板



▶ 高強度AlN基板

厚み：0.5、0.635、0.8、1.0、1.2mm

熱伝導率：170、200、230W/m K

サイズ：2、3、4.5inch

用途：LED/LDモジュール
パワーモジュール



お問合せはこちら▲